



tesamoll® Pianka UNIWERSALNA door-to-floor

Informacja Produkcie

BNR 05422

Opis produktu

Pianka tesamoll® UNIVERSAL Door-to-Floor Foam to ekonomiczna alternatywa dla szczotkowych uszczelnaczy drzwiowych. Jest w stanie uszczelnić szczeliny między drzwiami a podłogą do 20 mm.

Cechy

- Zatrzymuje przeciągi, kurz, zimno, ciepło, hałas i owady
- Dla równych podłóg
- Szybka i łatwa aplikacja
- Długotrwały

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------|
| • Materiał nośnika | pianka PVC | • Uszczelnia szczeliny od | 20 mm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|---------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność termiczna | tak |
| • Materiał | PVC | • trwałość | 2 years |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |



tesamoll® Pianka UNIWERSALNA door-to-floor

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>